Helsinki 26.02.99





E T U O I K E U S T O D I S T U S P R I O R I T Y D O C U M E N T



Hakija Applicant

AHLSTROM MACHINERY OY

Helsinki

Patenttihakemus nro

980519

Patent application no

200313

Tekemispäivä Filing date

06.03.98

Kansainvälinen luokka International class

D 21C

Keksinnön nimitys Title of invention

"Menetelmä massan käsittelemiseksi"

Täten todistetaan, että oheiset asiakirjat ovat tarkkoja jäljennöksiä patentti- ja rekisterihallitukselle alkuaan annetuista selityksestä, patenttivaatimuksista, tiivistelmästä ja piirustuksista.

This is to certify that the annexed documents are true copies of the description, claims, abstract and drawings originally filed with the Finnish Patent Office.

Pirjo Kaila Tutkimussihteeri

Maksu

245,- mk

Fee

245,- FIM

30

1

MENETELMÄ MASSAN KÄSITTELEMISEKSI FÖRFARANDE FÖR BEHANDLING AV MASSA

Esillä olevan keksinnön kohteena on menetelmä massan käsittelemiseksi kemiallisen massan alkalisen valmistus-5 prosessin yhteydessä, jossa massa käsitellään klooridioksidivaiheessa, johon kuuluu happokäsittely yli 80 °C:ssa. Erityisesti keksinnön kohteena on menetelmä massan valkaisemiseksi klooridioksidia hyväksikäyttävällä sekvenssillä mahdollisimman ympäristöystävällisesti. 10

Selluloosatehtaat ovat nykyisin pyrkineet eroon alkuainekloorin ja myös osittain klooridioksidin käytöstä. Syinä ovat sekä ympäristönsuojelulliset seikat että markkinatekijät. Alkuainekloorista aiheutuvat haittoja ovat sekä 15 selvästi havaittavat pahanhajuiset kaasumaiset päästöt että nestemäiset päästöt sellutehtailta vesistöihin. Nestemäinen klooridioksidi ei aiheuta hajuhaittoja samassa mittakaavassa, vaan sen haittavaikutukset kohdistuvat pääasiassa vesistöihin. Kuitenkin verrattaessa näitä 20 kloorikemikaaleja niiden vesistöille aiheuttamaa kuormitusta kuvaavan AOX-luvun avulla on alkuainekloori moninkertaisesti klooridioksidia haitallisempi kemikaali.

Kloorin AOX-luku on luokkaa 4 - 7 ja klooridioksidin 1 -25 1.5 tai jopa alle yhden.

Klooridioksidia käyttävät sekvenssit ovat kuitenkin edelleen suosittuja ja mahdollisia myös ympäristömielessä. Syitä siihen on monia. Klooridioksidi on muihin kemikaaleihin verrattuna hinnaltaan kilpailukykyinen. dioksidivalkaisulla saatavan massan lujuus- ja vaaleusar-Myös vot ovat hyvät. Itse asiassa vähintään samaa luokkaa kuin peroksidilla samalla kemikaalinkulutuksella (kg/admt).

Klooridioksidivalkaisu (D) on ennalta hyvin tunnettu ja 35 yleisesti käytetty valkaisumenetelmä. Tavanomaisessa klooridioksidivalkaisussa käytetään yleensä lämpötilaa 50 -

80 °C ja klooridioksidia annostellaan noin 10 - 30 kg massatonnia kohti. Käytettäviä sekvenssejä ovat mm. ${\rm D_0ED_1ED_2}$ ja ${\rm OD_0ED_1ED_2}$ sekä näiden erilaiset muunnelmat. ${\rm D_0-1}$ vaiheessa käsittelyaika on yleensä muita D-vaiheita lyhyempi, eli esimerkiksi 30 - 90 minuuttia. Massan pH laskee 5 alueelle 1 - 3 $\mathrm{D_0}$ - vaiheen lopussa. $\mathrm{D_1}$ - ja $\mathrm{D_2}$ -vaiheisssa käsittelyaika on 2 - 3 h ja pH vähän D₀-vaihetta korkeampi. Klooridioksidivaihe ajetaan yleensä lämpötilassa noin 70 °C käsittelyajan ollessa D_o-vaiheessa 0.5 - 2 10 tuntia ja D_1 - ja D_2 -vaiheissa 2 - 3 h. Korkeampia lämpötiloja on varottu, koska D-vaiheen alhainen alueella 1 - 3 yhdistettynä korkeaan lämpötilaan ja pitkään käsittelyaikaan vaurioittaa kuitujen lujuusominai-15

Nykyisin klooridioksidivalkaisun rinnalle ovat tulleet kloorittomia kemikaaleja, kuten peroksidia ja otsonia, käyttävät valkaisuprosessit. Koska klooridioksidivalkaistulla massalla on hyvät ominaisuudet, on tämän prosessin kehitystyötä jatkettu em. uusien prosessien lisäksi. Eräänä tärkeänä tavoitteena on vähentää valkaisussa tarvittavan klooridioksidin määrää ja näin tehdä menetelmä entistä ympäristöystävällisemmäksi.

: :::;

....

Suomalaisessa patenttihakemuksessa 944808 ja WO-patenttijulkaisussa 96/12063 on esitetty massan happokäsittelymenetelmä, jonka avulla klooridioksidin kulutusta voidaan
vähentää. Tässä käsittelyssä massasta poistetaan heksenuronihappoja, jotka voivat reagoida klooridioksidin
kanssa ja siten lisäävät kemikaalin kulutusta. Hapot
voidaan poistaa säätämällä massan pH-alueelle 2-5,
edullisesti 2.5-4 ja massan lämpötila yli 80 °C, edullisesti 90-110 °C:een, joissa olosuhteissa massaa pidetään
tyypillisesti 30-300 minuuttia. Käsittelyssä massan
kappaluku alenee tyypillisesti 2-9 yksikköä.

Lehtipuumassan valkaisussa on klooridioksidin kulutus vähentynyt 30-40 %:lla vaaleustasolla ISO 88 %, kun valkaisusekvenssi on O-A-D-E-D. Havupuumassan kohdalla vastaava kulutus on vähentynyt 10-20 %:lla. Kummassakin tapauksessa saanto pysyi suunnilleen muuttumattomana verrattuna valkaisuun ilman A-vaihetta

Esillä olevan keksinnön tarkoituksena on tarjota vaihtoehtoinen menetelmä kuuman happovaiheen liittämiseksi klooridioksidia käyttävään valkaisusekvenssiin. Lisäksi keksinnön tarkoituksena on tarjota menetelmä, jota voidaan taloudellisesti edullisella tavalla soveltaa erityisesti olemassaolevissa sellutehtaiden valkaisimoissa. Toisin sanoen keksinnön kohteena on sovittaa massan klooridioksidivalkaisu kokonaistaloudellisesti ja ympäristöystävällisesti valkaisimoon.

5

.;..;

Edellä mainittujen tarkoitusperien saavuttamiseksi on keksinnön mukaiselle menetelmälle ominaista, että klooridioksidikäsittelyssä olosuhteet ovat sellaiset, että massan sisältämät heksenuronihapporyhmät eivät reagoi klooridioksidin kanssa.

Yllä kuvattiin että massasta poistetaan heksenuronihapporyhmiä kuumalla happokäsittelyllä ennen klooridioksidikä-25 sittelyä. Olemme nyt keksinnössämme havainneet, että ${
m ClO_2}$ käsittely voidaan sijoittaa valkaisusekvenssissä myös ennen kuumaa happokäsittelyä, kun massan heksenuronihapporyhmien ja klooridioksidin väliset reaktiot estetään. Dvaihe käsittää siis peräkkäisesti D- ja A-portaan. Keksin-30 nön menetelmässä DA-vaiheen klooridioksidiporras tehdään niin, että loppu-pH on yli 4, edullisesti yli 5. Perinteisesti ensimmäisen tai toisen klooridioksidivalkaisuvaiheen loppu-pH on alle 4, tyypillisesti 1 - 3.5. On yllättäen todettu että heksenuronihapot eivät reagoi klooridioksidin 35 kanssa pH-alueella yli 4 ja näin kemikaalia ei kulu klooridioksidin kanssa. Klooridioksidi

pelkistyy kloriitiksi, mutta se ei hajoa edelleen. Klooridioksidiannos tässä portaassa on edullisesti 0.1 - 1.5 % akt.Cl (1-15 kg akt.Cl/admt), edullisesti yli 0.5 - 10 % akt.Cl (5-10 kg akt.Cl/admt).

5

Happokäsittelyssä (A-porras) olosuhteet ovat tyypillisesti seuraavat:

- pH 2-5, edullisesti 2.5-4
- lämpötila yli 80 °C, edullisesti 90-110 °C
- aika 30-300 min, edullisesti ainakin t minuuttia, $t = 0.5 \exp(10517/(T+273) -24)$ (t =
 - 0.5 $e^{((10517/(T+273))}$ -24)), jossa T (°C) on happokäsittelyn lämpötila.
- Keksinnön DA-vaiheen D-portaassa lämpötila on edullisesti yli 70 °C, edullisesti 80 100 °C, mikä on tavanomaista D-vaiheen lämpötilaa on korkeampi. D- ja A-portaiden lämpötila voi siis olla oleellisesti sama, jolloin massaa ei tarvitse huomattavasti jäähdyttää tai lämmittää portaiden välillä, mikä on energiataloudellisesti edullinen ratkaisu. Keksintö ei ole kuitenkaan rajoitettu em. korkeaan lämpötilaan, vaan neutraali D-porras voidaan ajaa myös tavanomaisessa D-vaiheen lämpötilassa alle 70 °C.
- Keksinnön D-portaassa käsittelyaika on edullisesti lyhyt, 25 alle 10 minuuttia, edullisesti 30 sekuntia - 3 minuuttia. Perinteisesti klooridioksidikäsittelyn aika on yli 30 min, jopa 120 minuuttia lämpötilasta riippuen, minkä vuoksi käsittely on tehtävä omassa reaktorissa. Keksinnön mukainen DA-vaihe voidaan toteuttaa siten että happokäsit-30 tely tapahtuu reaktoritornissa, mutta A-porrasta edeltävä D-porras voidaan lyhyen viipymäajan takia järjestää esimerkiksi A-tornin syöttölinjaan. Linjassa virtaava massa lämmitetään haluttuun lämpötilaan, esim. 90 °C, ja siihen sekoitetaan kemikaaleja, kuten klooridioksidia ja 35 tarvittaessa pH:n säätöön alkalia tai happoa. Näissä olosuhteissa massa virtaa halutun ajan esim. 1 minuutin,

jonka jälkeen siihen lisätään happoa ja se syötetään happotorniin.

Sijoittamalla klooridioksidikäsittely ennen happokäsittelyä pienenee hapon tarve A-portaassa, koska klooridioksidin reaktiot ligniinin kanssa tuottavat suolahappoa ja orgaanisia happoja sivutuotteena.

5

10

15

20

25

30

35

Keksinnön erään edullisen suoritusmuodon mukaiselle menetelmälle on ominaista, että keksinnön mukainen klooridioksidivaihe käsittää edellä kuvattujen D- ja A-portaiden lisäksi toisen D-portaan eli ko. vaihe käsittää ensimmäisen klooridioksidiportaan, kuuman happokäsittelyportaan ja toisen klooridioksidiportaan (DAD, merkitään myös D/A/D).

Toinen D-porras suoritetaan happamissa olosuhteissa eli pH voi olla alle 2, mutta edullisesti 2-4. Näin mitään olennaista pH:n säätöä A-portaan jälkeen ei tarvita. Myös lämpötilan säätöä ei välttämättä tarvita, vaan koko klooridioksidivaihe voidaan tehdä oleellisesti samassa lämpötilassa kuin A-porras eikä olennaisia lämpötilan muutoksia portaiden välillä tarvitse tehdä. Tämä helpottaa huomattavasti ko. vaiheen prosessiteknistä suoritusta.

Myös toisen D-portaan käsittelyaika on edullisesti lyhyt, alle 10 minuuttia, edullisesti 1-5 minuuttia ja se voidaan toteuttaa esim. A-tornin poistolinjassa ennen DAD-vaihetta seuraavaa pesuria. Poistolinjassa virtaavaan massaan lisätään klooridioksidia ja tarvittaessa lämpötilaa ja pH:ta säädetään. Tarvittava klooridioksidiannos on tyypillisesti 5 - 20 % akt. Cl (5 - 20 kg akt. Cl/admt). Happokäsittelyssä massasta poistetaan heksenuronihappoja, minkä vuoksi tarvittavan klooridioksidikemikaalin määrä on pienempi verrattuna massaan, josta heksenuronihappoja ei ole poistettu.

Keksinnön tässä toteutusmuodossa DAD voidaan katsoa, että klooridioksidikäsittely on jaettu kahteen suhteellisen

10

15

20

25

30

35

lyhyeen osakäsittelyyn. Kumpikin vaihe voidaan ajaa korkeassa lämpötilassa, minkä vuoksi lämpötila ja käsittelyaika tulee sovittaa niin, että massan viskositeettitappiot ovat mahdollisimman pienet. Kahden osakäsittelyn vuoksi massan vaaleus saadaan tasaisemmaksi.

DA-vaihe voidaan toteuttaa myös niin, että A-portaan jälkeen seuraa massan kelatointikäsittely EDTA: 11a, DTPA: lla tai vastaavalla yhdisteellä haitallisten metallien poistamiseksi eli tällöin vaihe on DAQ. Kelatointikäsittelyn yhdistäminen DA-vaiheeseen on edullinen varsinkin silloin, jos **v**alkaisusekvenssissä myöhemmin seuraa valkaisu kemikaalilla, kuten peroksidilla, jota vaihetta raskasmetallit haittaavat. Q-portaassa voi olla oleellisesti sama lämpõtila kuin edeltävissä D- ja A-portaassa. pH:n voi olla alueella noin 3-6.

Vaiheessa DA tarvittavan klooridioksidin kokonaismäärä ei ole suurempi kuin vaiheessa AD tarvittava määrä, vaikka ensimmäinen D-porras tehdäänkin ennen happokäsittelyä. Neutraali pH ensimmäisessä D-portaassa estää heksenuronihappojen ja klooridioksidin väliset reaktiot. Vaiheessa DA on saatu ainakin yhtä hyvä laatuista massaa kuin vaiheessa AD. DA-vaiheen tai useampiportaisen DAD-vaiheen etuna verrattuna AD-vaiheeseen on se, että DA- tai DAD-vaihe voidaan toteuttaa laiteteknisesti yksinkertaisemmalla koska jokaiselle portaalle ei tarvita omaa tornia. Tosin keksintöä voidaan soveltaa myös siten, että toinen tai molemmat D-portaat ajetaan omissa torneissa.

AD-vaiheen haittana saattaa olla hajukaasujen vapautuminen happoportaassa, jos massa sisältää vielä pesun jälkeen riittävässä määrin keitosta peräisin olevia rikkiyhdisteitā. Kun D-porras on ennen A-porrasta, hajukaasut hapettuvat valkaisukemikaalin vaikutuksena DA-vaiheen aikana.

Keksinnön mukaista ratkaisua voidaan soveltaa sulfaattiprosessilla ja muilla alkalisilla menetelmillä valmistetuille massoille, jotka sisältävät heksenuronihapporyhmiä. Käsiteltävä massa on edullisesti happidelignifioitua.

Keksinnön mukainen DA-vaihe voi olla valkaisusekvenssin alussa esim. happidelignifioinnin jälkeen tai myöhemmin sekvenssissä esim. peroksidivaiheen jälkeen. Siksi keksinsovelletaan edullisesti esim. seuraavien valkaisuosasekvenssien tai valkaisusekvenssien yhteydessä:

10 Keitto- O - DAD - E,

5

15

30

Keitto - O - DAD - E - D_N - D tai Keitto - O - Q - OP - D/A/Q - PO, missä

- tarkoittaa pesua vaiheitten välillä,

O kuvaa ainakin happea käyttävää delignifiointivaihetta,

Q kelatoimalla suoritettavaa metallinpoistoa,

A kuumaa happokäsittelyä,

E alkalista vaihetta, ja

OP tai PO happi- ja/tai peroksidipohjaista valkaisu-20 vaihetta, mahdollisesti ainakin osalta portaista paineistettuna, jossa O tarkoittaa happikemikaalia ja P peroksidia ja jossa ensimmäinen kirjain kussakin portaassa tarkoittaa pääasiallisesti vaikuttavaa valkaisukemikaalia ja mahdollinen toinen kirjain val-25 kaisureaktiota tukevaa valkaisukemikaalia.

Seuraavassa keksinnön mukaista menetelmää selitetään yksityiskohtaisemmin viittaamalla oheiseen kuvioon, joka esittää erästä edullista laitteistoa erään keksinnön mukaisen menetelmän toteuttamiseksi. Massa käsitellään vaiheessa DAD.

Massa siirretään edeltävästä käsittelyvaiheesta sakeamassapumpulla 12 happotorniin 18. Massan sakeus on 6-35 25 %, edullisesti 8-18 %. Edeltävä käsittelyvaihe voi olla massan keittoa seuraava pesu tai tavallisimmin keittoa seuraava happidelignifiointi tai sitä seuraava pesu.

Massaan lisätään tarvittaessa alkalia tai happoa massan alku-pH:n säätämiseksi klooridioksidikäsittelyä ensimmäistä D-porrasta varten siten, että loppu-pH on yli 4, edullisesti yli 5, klooridioksidin ja heksenuronihappojen välisten reaktioiden estämiseksi. Alkali ja klooridioksidi voidaan lisätä suoraan pumppuun 12, injektoida pumpun 12 ja tornin väliseen putkeen 16 tai erityiseen, tarkoitusta varten järjestettyyn sekoittajaan 14. Klooridioksidia lisätään tyypillisesti 0.5-1.5 % akt. Cl.

10

15

25

30

35

5

Lämpötilan nostamiseksi tyypillisesti 80-100 °C:een massaan lisätään höyryä. Höyry voidaan lisätä ennen pumppua 12 höyrysekoittimessa (ei esitetty) tai sekoittaa pumpun 12 jälkeen putkessa 15. Vaihtoehtoisesti massa voidaan lämmittää myös epäsuoralla lämmityksellä putkessa 15.

Ensimmäinen D-porras tapahtuu siten happotornin syöttölin-20 jassa 15 massan virratessa siellä. Käsittelyaika tässä portaassa on tyypillisesti 30 s- 3 min.

D-porrasta seuraa happokäsittely tornissa 18. Klooridioksidikäsittelyn jälkeen massan pH lasketaan happokäsittelyn vaatimaan arvoon 2-5 lisäämällä sekoittimessa 14 massaan happoa (rikkihappo, suolahappo, jätehappo tai jokin sopiva orgaaninen happo). Lämpötilaa voidaan myös tarvittaessa säätää, mutta keksinnön mukaisessa DAD-vaiheessa portaat suoritetaan edullisesti samassa lämpõtilassa, esim. 95°C, jolloin oleellista lämpötilan säätöä portaiden välillä ei tarvita.

Massan syöttö ja virtaus happotorniin pyritään saamaan mahdollisimman tasaiseksi käyttämällä jakolaitetta 16 tai kaavaria. Mainittu jakolaite on kuvattu esimerkiksi USpatentissa 4,964,950 ja sen käyttöä edellä kuvattuun tarkoitukseen on käsitelty FI-patenttihakemuksessa 924805.

Laitteen 16 kautta voidaan haluttaessa (jos laite omaa riittävän tehokkaat sekoitusominaisuudet) lisätä happoa ja täten on jopa mahdollista välttää laitteen 14 käyttö/hankinta. Laitteesta 16 massa virtaa reaktorisäiliöön 18, joka on mitoitettu happokäsittelyn vaatimalle käsittelyajalle, esim. 120 min 95 °C:ssa. Käytettäessä mainitun FIhakemuksen mukaista jakavaa syöttölaitetta voidaan varmistaa, että torni täyttyy joka osaltaan tasaisesti ja että massapilari tornissa kohoaa tasaisesti ylöspäin niin, että mitään haitallista kanavoitumista ei pääse syntymään. Vastaavasti tornin huippu on varustettu purkaimella 20 tai poistokaavarilla massan johtamiseksi tornin poistolinjaan 24.

5

10

25

30

35

Poistolinjassa 24 suoritetaan toinen D-porras massan valkaisemiseksi. Klooridioksidia voidaan lisätä massaan happotornin purkaimen 20 tai poistolinjan pumpun 22 kautta. Linjaan 24 voidaan järjestää myös erillinen sekoitin (ei esitetty) kemikaalin lisäystä varten, joka on noin 5 - 20 % akt. Cl.

Valkaisukemikaalin lisäys massaan sovitetaan niin että saavutetaan sopiva käsittelyaika D-portaan suorittamiseksi poistolinjassa 24 ennen pesuria 26. Viipymäaika on alle 10 minuuttia, edullisesti 1-5 minuuttia. Tämän D-portaan käsittelylämpötila on edullisesti sama kuin aikaisemmissa D- ja A-portaissa, jolloin nytkään ei tarvita olennaista lämpötilan säätöä A-portaan jälkeen. Tarvittaessa massaan voidaan lämmittää tai jäähdyttää lämmönsiirtimessä tai suoralla höyryn syötöllä. Tavanomaista korkeampi lämpötila on kuitenkin edellytys että riittävä valkaisuvaikutus saadaan aikaan em. lyhyen käsittelyajan aikana.

Toisen D-portaan pH on alhaisempi kuin ensimmäisessä Dportaassa. Tyypillisesti pH on noin 2-4, minkä vuoksi pH:n säätöä A-portaan jälkeen ei normaalisti tarvita. Tarvitta-

essa pH:ta säätävä kemikaali voidaan lisätä samassa vaiheessa kuin klooridioksidi.

Edellä kuvatulla tavalla massa on valkaistu vaiheessa DAD, minkå jälkeen massa käsitellään pesurissa 26 ja johdetaan 5 jatkokäsittelyyn. Tyypillisesti seuraava vaihe on E-vaihe.

Esimerkki:

Laboratoriossa tutkittiin happivalkaistua massaa, jonka kappaluku oli 11,9, viskositeetti 1061 ml/g ja ISO-vaaleus 10 49,2 %. Massa käsiteltiin seuraavilla sekvensseillä:

1. DAD - E - DN - D

- ClO2 -annos akt. Cl:na 1,0 % D:

15 - aika 1 min

- loppu-pH 5,3

- lämpõtila 95 °C

Α: - aika 180 min

- pH 3,5

20 - lämpõtila 95 °C

- ClO₂ -annos akt. Cl:na 1,25 %

- aika 2 min

- loppu-pH 2,5

- lämpötila 95 °C

25 - 85 °C, 60 min, 1,25 % NaOH, O₂ 4 bar, loppu-pH 11,7

- kappaluku käsittelyn jälkeen 2,3

- viskositeetti käsittelyn jälkeen 890 mg/l

- vaaleus käsittelyn jälkeen 70,2 % ISO.

- 75 °C, 180 min, 1,8 % ClO₂ akt.Cl:na, 0,3 % NaOH, loppu-pH 3,3

- N PH:n säätö 8,3

- 75 °C, 180 min, 0,8 % ClO₂ akt.Cl:na, 0,1 % NaOH, D

loppu-pH 5,1

Valkaistu massa: viskositeetti 868 ml/g Vaaleus 89,9 % ISO

Toisessa kokeessa samaa massaa käsiteltiin

2. AD - E_O - D_N - D

. A: - aika 180 min

40 - pH 3,5

30

35

- lampotila 95 °C

D: - ClO2 -annos akt. Cl:na 2,25 %

- aika 1 min

- loppu-pH 2,1

10

15

20

25

- lämpötila 95 °C

5 E_o: - 85 °C, 60 min, 1,25 % NaOH, O₂ 4 bar, loppu-pH 11,6

- kappaluku käsittelyn jälkeen 2,7

- viskositeetti käsittelyn jälkeen 890 mg/l

- vaaleus käsittelyn jälkeen 69,4 % ISO.

D_N - 75 °C, 180 min, 1,8 % ClO₂ akt.Cl:na, 0,3 % NaOH, loppu-pH 3,4 ~ N pH:n săătö 8,3

D - 75 °C, 180 min, 0,8 % ClO₂ akt.Cl:na, 0,1 % NaOH, loppu-pH 5,1

Valkaistu massa: viskositeetti 866 ml/g vaaleus 89,9 % ISO.

Kokeen perusteella voidaan todeta että keksinnön mukaisella vaiheella DA ja vaiheella AD saadaan samanlaatuista massaa. Toteuttamalla klooridioksidi- ja happokäsittely keksinnön mukaisella tavalla voidaan saavuttaa joitain edellä kuvattuja käytännön etuja.

Vaikka keksintöä on tässä esitetty ja kuvattu nykytiedon mukaan käytännöllisimmän ja edullisimman suoritusmuodon mukaan, alan ammattimiehille on selvää, että monia muunnelmia voidaan tehdä keksinnön suojapiirissä, jolle suojapiirille tulee antaa oheisten patenttivaatimusten mukainen laajin mahdollinen tulkinta, jotta se käsittää kaikki vastaavat menetelmät.

13

Patenttivaatimukset:

15

30

35

- 1. Menetelmä massan käsittelemiseksi kemiallisen massan alkalisen valmistusprosessin yhteydessä, jossa massa käsitellään klooridioksidivaiheessa, johon kuuluu happokäsittely pH:ssa 2-5 ja yli 80 °C:ssa, tunnettu siitä, että klooridioksidikäsittelyssä olosuhteet ovat sellaiset, että massan sisältämät heksenuronihapporyhmät eivät reagoi klooridioksidin kanssa.
 - 2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että klooridioksidivaiheeseen kuuluu peräkkäisesti ainakin klooridioksidiporras ja happokäsittelyporras.
 - 3. Patenttivaatimuksen 2 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että klooridioksidiportaan pH:ta säädetään niin, että portaan lopullinen pH on yli 4.
- 4. Patenttivaatimuksen 3 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että klooridioksidiportaan pH:ta säädetään niin, että portaan lopullinen pH on yli 5.
- 5. Jonkin patenttivaatimuksen 1-4 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että klooridioksidiportaassa lämpötila on yli 70 °C.
 - 6. Patenttivaatimuksen 5 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että klooridioksidiportaassa lämpötila on 80-100 °C.
 - 7. Jonkin edellä olevan patenttivaatimuksen mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että klooridioksidiportaassa käsittelyaika on alle 10 min, edullisesti 30s 3 min.
 - 8. Jonkin edellä olevan patenttivaatimuksen mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että klooridioksidivaiheeseen

kuuluu ensimmäisen klooridioksidiportaan lisäksi toinen klooridioksidiporras, joka on happokäsittelyportaan jälkeen.

- 9. Patenttivaatimuksen 8 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että ensimmäisen klooridioksidiportaan, happokäsittelyportaan ja toisen klooridioksidiportaan käsittelylämpötila on oleellisesti sama.
- 10. Jonkin patenttivaatimuksen 1-6 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että klooridioksidivaiheeseen kuuluu klooridioksidiportaan ja happokäsittelyportaan jälkeen käsittely kelaatinmuodostajalla.

(57) Tiivistelmä

Esillä oleva keksintö koskee menetelmää massan käsittelemiseksi kemiallisen massan alkalisen valmistusprosessin yhteydessä. Massa käsitellään klooridioksidivaiheessa, johon kuuluu peräkkäisesti edullisesti klooridioksidiporras ja happokäsittelyporras pH:ssa 2-5 ja yli 80 °C:ssa. Klooridioksidiportaassa olosuhteet ovat sellaiset, että massan sisältämät heksenuronihapporyhmät eivät reagoi klooridioksidin kanssa.

